

プリント基板向け直接描画装置の高生産性モデルを開発 ～「Lediaシリーズ」のラインアップ拡充で、新たな市場ニーズに対応～

株式会社SCREEN PE ソリューションズはこのほど、5G関連を中心に急速に需要が高まっているHDI（高密度多層）基板やパッケージ基板などのパターン形成に対応する、プリント基板向け直接描画装置の高生産性モデル「Ledia Twin（レディア・ツイン）」を開発。2021年1月から販売を開始します。

Ledia Twin

☆この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、
下記URLよりダウンロードできます。
(www.screen.co.jp/about/nr-photo_2020)

販売開始予定	2021年1月
年間販売予定台数（初年度）	25台



近年、世界各国で進む5G（第5世代移动通信システム）の導入に伴い、5G対応スマートフォンや基地局、データセンター向けプリント基板の需要が急速に拡大しています。しかし、小型化・高密度化が進む5G関連やデータセンター向けHDI基板、およびパッケージ基板においては、従来よりも精密なパターン形成が必要となることから、各基板メーカーでは高精細な描画性と高生産性の両立が急務となっています。

このような動向を背景に当社は、プリント基板向け直接描画装置として全世界で累計600台以上の導入実績を持ち、ソルダーレジスト^{※1}向けとして業界のデファクトスタンダードとなっているLediaシリーズの最新機種「Ledia Twin」を開発しました。この装置は、ソルダーレジスト部において穴径60 μ mの開口パターン露光に対応するなど、Lediaシリーズの特長である高精細な描画性能はそのままに、新たにツインステージ機構を採用。片側ステージでの露光中に、もう一方のステージで基板の入れ替えやアライメントマークのスキャンが可能のため、作業時間の大幅な短縮を実現します。さらに、光源のハイパワー化によって描画時間を短縮するなど、生産性を最大で約50%向上^{※2}させています。

なお「Ledia Twin」は、10月21日（水）から23日（金）まで台湾・台北南港展覽館ホール1で開催される「TPCA Show 2020」、および当社公式Webサイト内のバーチャル展示会でご紹介します。

当社は、今回のLediaシリーズのラインアップ拡充により、5Gを中心に活性化するHDI・パッケージ基板市場へのビジネス展開を加速させるとともに、環境保全や自動化などプリント基板業界のニーズに応え、同業界の発展に貢献していきます。

バーチャル展示会

SCREEN PE ソリューションズの公式Webサイト内で、プリント基板関連機器をバーチャル展示会でご紹介します。

URL : www.screen.co.jp/pe/experiences/



TPCA Show 2020

プリント基板をはじめとするエレクトロニクス産業の包括的な機器、材料、および技術に関する展示会。

URL : tpcashow.com/

※1 ソルダーレジスト：基板の表面を覆う絶縁保護膜のこと。

※2 当社従来製品比

● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREEN PE ソリューションズ 営業統轄部 営業部 マーケティング課 Tel: 075-417-2704 pe-info@screen.co.jp